

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司

接待机构投资者调研活动会议纪要

一、机构调研情况

调研时间：2020 年 10 月 28 日、29 日

调研地点：公司办公楼二楼会议室（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

调研形式：现场接待及电话会议

来访机构： 博时基金、天风证券、中信建投证券、海通证券、光大证券、广发证券、方正证券、汇添富基金、交银施罗德基金、富国基金、国泰君安公司自营、国寿安保基金、中海基金、国海富兰克林基金、华商基金、博笃投资、中信证券权益、东北证券、中天国富证券、中融基金、深圳中融鼎投资、中华联合保险、招商基金、兴业基金、江海证券、财通基金、上海金辇投资、浦银安盛基金、深圳市中欧瑞博投资、深圳市前海登程资产管理、深圳宏鼎财富管理、深圳广汇缘资产管理、上海逐流资产管理、上海煜德投资、上海仙湖投资、上海汐泰投资、上海仁优投资、上海混沌投资、上海瑰铄资产管理、上海复胜资产管理、上海鼎锋资产管理、上海大正投资、上海保银投资管理、上海青骊投资管理、诺德基金、江苏恒道资本管理、华夏久盈资产管理、华泰瑞联、华安基金、湖南源乘投资管理、杭州红骅投资管理、国信证券、晨燕资产管理、北京润晖资产管理、Ten Asset

Management、Parantoux Capital。

公司接待人员：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 吴能云；
财务经理 罗文军。

二、调研行程安排

2020 年 10 月 28 日 09：00-10：20 博时基金与公司领导进行现场交流，10：30-11：30 博时基金参观公司部分生产线和展厅。

2020 年 10 月 28 日 10：30-11：30 由天风证券牵头的 47 家投资机构与公司领导举行电话会议，会议由天风证券的陈俊杰主持。

2020 年 10 月 28 日 15：20-16：30 由中信建投证券牵头的 6 家投资机构与公司领导举行电话会议，会议由中信建投证券的孙芳芳主持。

2020 年 10 月 29 日 09：00-10：30 方正证券与公司领导进行现场交流。

三、调研会议纪要

（一）公司概况介绍环节

会议开始，由公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云先生向与会者介绍了公司目前的发展概况。公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实

力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为 2017 年“中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料十强企业”第一名。目前公司已经成为国内少有的具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片及芯片制造的完整产业链的集成电路企业。经过近 20 年的积累和发展，公司形成的技术与研发优势、人才与团队优势、行业先发优势和规模优势、产业链一体化优势、质量与客户优势，成为立昂微得以稳定发展的重要保障。最后，吴能云先生向来宾介绍了目前公司的三大业务板块：集成电路用硅片、半导体分立器件、砷化镓射频芯片的主要代表产品的生产工艺、技术性能、应用领域等基本概况，另外对公司 2020 年第三季度的业绩情况进行了说明。

（二）会议问答环节，交流的主要问题及公司回复概要

1、请问：公司 2020 年三季报的营收、利润都不错，前三季度超过了去年全年的业务，但第三季度的毛利率同比下降了 3 个百分点左右，这是什么原因？

答：主要原因是 2019 年下半年产品售价有所下调。2018 年开始行业景气度开始往上走，2019 年上半年达到行业景气度的高点，硅片销售价格从 2018 年下半年到 2019 年上半年一共提价了三次，但从 2019 年下半年开始集成电路产业，包括硅片行业景气度下滑，在 2019 年下半年硅片产品售价有所下调，另外由于衢州新的硅片生产基地目

前正处于产能爬坡阶段，分摊的长期投资折旧较多，导致三季度毛利率同比和环比下降。

2、请问：目前行业景气度提升，公司的主要产品是否有涨价预期？

答：得益于二季度末开始集成电路行业景气度不断提升，公司目前在手订单饱满，生产满负荷运转，产品供不应求。基于上述市场情况，对于涨价事宜目前公司正在和客户沟通，产品涨价需要双方协商才能最终确定。部分产品已实施涨价。

3、请问：砷化镓射频芯片对利润端的贡献目前还是为负，这一块的业务前景还是非常好的，主要客户有哪些？另外，请介绍下明年或者后年砷化镓射频芯片业务情况。

答：砷化镓射频芯片项目自 2016 年开始建设，2019 年 5 月年产 3 万片的产能建成投产，经过二年多的技术积累和客户验证，目前已进入到业务放量阶段，预计明年一季度将实现满产。目前主要的客户是国内做手机芯片设计和人脸识别芯片设计的相关客户。目前正在实施扩产，预计到 2021 年 6 月底产能将达到年产 7 万片。砷化镓芯片业务将是公司明年业绩的主要增长点之一。

4、请问：公司正在重点建设的 12 英寸硅片项目进展如何？

答：目前 12 英寸硅片项目已通过数家客户的产品验证，并实现小规模的生产与销售。项目正处于持续扩建过程中，计划将于 2021 年 12 月底前完成月产 15 万片的产能建设。另外目前公司正在推进

12 英寸硅片项目承担单位金瑞泓微电子新增 13 亿资本金的事宜，具体见公司的公告。

5、请问：公司硅片供自己做 MOS 和肖特基的占比多少？

答：母公司做的肖特基和 MOS 芯片所需要的 6 英寸外延片全部依靠公司内部提供，目前每月内部提供的数量在 11 万片左右。

6、请问：公司有三块业务，互相之间关联度不能算是特别高，特别是人才方面，我们战略上是怎么考虑的？如何在各个事业部找到合适的人才去做这个事情？

答：公司三大业务板块的人才都是独立的。从硅材料业务板块来看，浙江金瑞泓是 2000 年成立的，投产以后在 2003 年至 2006 年期间招聘了大批的浙大硅材料专业的本科生、硕士生，经过 5-10 年的培养，这部分学生成为公司的技术骨干、管理骨干，当初招聘进来以后，公司实施了许多留住人才的激励政策，现在非常稳定。

从分立器件板块来看，公司 2002 年成立的时候引进了美国安森美一条半导体的生产线，包括整套质量控制体系、技术标准、软件包全部引进。这条生产线非常稳定，良率非常高。分立器件业务的要求主要是严格按照质量体系、工艺标准进行生产，人才流动对业务的影响不是很大。

从砷化镓射频芯片板块来看，砷化镓射频芯片的人才主要得益于浙江省委组织部帮公司引进的一个省级创业创新团队，这个团队表现非常专业，也非常稳定，依靠这个团队顺利地实施了砷化镓射频芯片的研发和生产。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日